

## 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于签订投资意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、本意向书仅为框架意向约定，系双方建立合作关系的初步意向，为各方进一步讨论的基础，项目的具体实施尚需进一步洽谈，双方能否就具体项目达成合作并签署正式协议存在一定的不确定性。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《重大投资决策管理制度》等有关规定，本意向书涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将在签订正式协议时，根据协议金额及交易实质，依据法规履行相应审议程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、截止本公告披露之日，双方尚未开展具体合作事宜。本意向书的履行对公司 2018 年度经营业绩不构成重大影响。

### 一、投资意向书签订的基本情况

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与惠州仲恺高新区东江高新科技产业园管理委员会(以下简称“东江科技园”或“甲方”)于 2018 年 12 月 18 日在惠州签订了《项目投资意向书》(以下简称“意向书”)，拟约定公司在东江科技园内注册设立独立企业法人，并由该企业法人投资建设溅射靶材及溅射设备关键部件产业化项目(以下简称“投资项目”或“项目”)。公司与东江科技园无关联关系。

本意向书仅为意向性约定，签订程序无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《上市规则》、《公司章程》等法律、

法规、规范性文件及公司制度的有关规定和要求，履行相应的决策、审批程序及信息披露义务。

## 二、投资意向书的主要内容

### （一）合作目的、合作规模及合作模式

甲方在惠州仲恺（国家级）高新技术产业开发区区委、区管委会统一领导、规划、建设及管理下，承担东江科技园的开发建设职能和相关社会管理职能。甲方希望引进乙方在东江科技园开展项目投资建设。

乙方专业从事超大规模集成电路芯片制造用超高纯金属材料及溅射靶材的研发、生产和销售，希望在东江科技园开展溅射靶材及溅射设备关键部件产业化项目的投资建设。

项目的基本情况如下：

- 1、拟建项目名称：溅射靶材及溅射设备关键部件产业化项目
- 2、项目选址：惠州仲恺（国家级）高新技术产业开发区内的工业用地
- 3、项目占地面积：项目用地面积约 2.47 万平方米（最终以国土部门实际挂牌面积为准）。

### （二）协议双方的主要权利和义务

1、在符合法律、法规的前提下，甲方同意将项目用地的土地使用权依法出让给乙方，并按照“六通一平”（即通路、通水、通电、通排水、通排污、通电讯，场地平整）的标准交付乙方使用。乙方同意受让项目用地的土地使用权并支付土地价款及有关税费；且未经甲方事先同意，不将项目用地转让给第三方。

2、投资项目建设和经营期间，甲方同意向乙方提供投资项目涉及的投资服务和公共管理，协助乙方开展项目投资建设，包括但不限于协助乙方依法取得项目用地的土地使用权、办理投资项目规划和施工许可、投资项目环境影响评价手续等；并妥善解决乙方在投资项目建设和经营过程中涉及的问题以及合理的诉求。

### （三）协议的生效条件、生效时间及有效期限

本意向书自双方代表人签字并加盖双方印章之日起成立，至双方签署投资协议或具有约束力的其他法律文件之日或者一方书面通知终止协商之日终止，以先到者为准。

### 三、对上市公司的影响

#### 1、对上市公司业绩的影响

本次合作的具体安排尚待双方进一步商议确定，有关合作事项须以双方签署的正式投资协议或具有约束力的其他法律文件为准。截止本公告披露之日，双方尚未开展具体的合作事宜，且本次合作属于双方合作的意向性约定，因此，本次合作对公司 2018 年的营业收入、净利润不会构成重要影响，对公司长期收益的影响尚无法预测。

#### 2、对上市公司经营的影响

如本次合作签订并履行正式协议，开展溅射靶材及溅射设备关键部件产业化项目的投资建设，将对公司未来发展具有积极意义，有利于公司实施战略发展规划，进一步增强公司的综合竞争力和盈利能力。

### 四、重大风险提示

1、本意向书仅为框架意向约定，系双方建立合作关系的初步意向，为各方进一步讨论的基础，项目的具体实施尚需进一步洽谈，双方能否就具体项目达成合作并签署正式协议存在一定的不确定性。

2、根据《上市规则》、《重大投资决策管理制度》等有关规定，本意向书涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将在签订正式协议时，根据协议金额及交易实质，依据法规履行相应审议程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

《项目投资意向书》

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日